113學年度課程規劃表　電子工程系-封裝測試產業精英專班　進修部二技

第一學年(113)						第二學年(114)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
專業必修	※測試能力鑑定(一)	3	3			專業必修	※封裝能力鑑定(一)	3	3		
	※BIB治具設備操作與維修概論	3	3				※Tester設備操作與維修概論	3	3		
	※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3				※Handler設備操作與維修概論	3	3		
	※Lead Scanner原理與應用	3	3				※HF設備操作與維修概論	3	3		
	※半導體製程實務	3	3				※積體電路工程	3	3		
	※實務專題	3	3				※半導體元件	3	3		
	※半導體產業分析			3	3		※半導體製程技術			3	3
	※捲帶機原理與應用			3	3		※積體電路可靠性工程			3	3
	※打線機原理與應用			3	3		※Oven設備操作與維修概論			3	3
	※黏晶機設備操作與維修概論			3	3		※LD/UL設備操作與維修概論			3	3
	※測試能力鑑定(二)			3	3		※治具設備操作與維修概論			3	3
	※實務專題			3	3		※封裝能力鑑定(二)			3	3
	小計	18	18	18	18		小計	18	18	18	18

【科目類別】

通識科目(分類通識)：校必修

專業科目：院必修、專業必修、專業選修

【科目類別】		學分	時數
通識科目	校必修		
專業科目	院必修		
	專業必修	72	72
	專業選修		
	合計	72	72

電子工程系主任張丞勛

明新學校財團法人明新科技大學 電子工程系 新竹縣新豐鄉新興路1號

半導體學院院長張合

【注意事項】

1. 最低畢業學分：72 學分，其中專業選修0學分(本系至少0學分，其餘可跨系)。
2. 表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。

113.03.05